

61668-2 ✓ 有效

AMPMODU | UTILUX CR

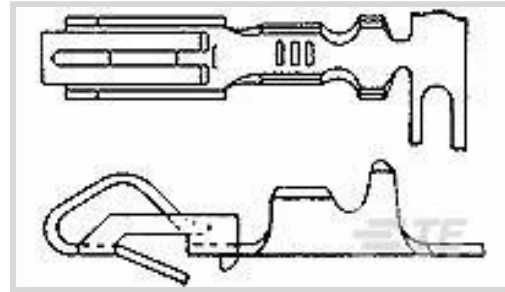
TE 内部编号 61668-2

Hermaphroditic Contact, Tin, Snap-In Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .2 – .8 mm<sup>2</sup> Wire Size, Crimp, Phosphor Bronze, Signal, UTILUX CR

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 无极性

端子接触部电镀材料: 锡

壳体内部的端子定位器类型: 卡口

线径: .2 – .8 mm<sup>2</sup>

## 产品特性

### 接触件特性

端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子类型	无极性
端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	6 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

### 机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
壳体内部的端子定位器类型	卡口

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.79 mm[.11 in]
线径	.2 – .8 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-55 – 105 °F]
--------	----------------------------

## 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 包装特性

封装数量	6000
封装方法	Box

## 产品合规性

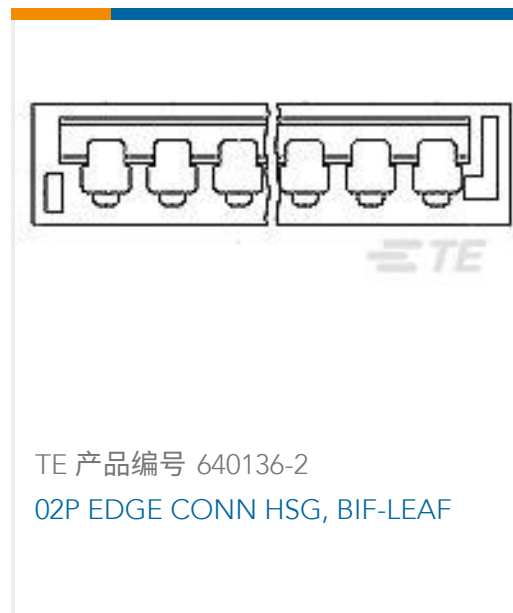
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件





该系列中的其他产品 | UTILUX CR



客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[BIF-LEAF CONT CR/SNAP PTPPHBZ](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_61668-2\\_AS.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_61668-2\\_AS.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_61668-2\\_AS.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

[Bifurcated Leaf Contact](#)

英文版本

### 应用规格

英文版本